

**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



산업용 사용을 위한 신뢰할 수 있는 데이터 인터페이스인 USB 장점이 많기 때문에 USB 잭은 전기 산업에서 항상 가장 많이 사용됩니다.

USB-A, -B, -C 및 -Micro 부품의 광범위한 포트폴리오는 최대 10 Gbit/s의 속도로 미래형 장치 디자인을 가능하게 합니다. 당사의 USB PCB 잭은 빠르고 쉬운 데이터 전송을 위해 견고한 표준 USB 2.0, 3.0 및 3.1을 지원합니다.

개별 커넥터는 높은 내구성에 대한 요구 사항을 충족하며 안정적인 연결을 제공합니다.

- 최대 10.000 플러그 주기
- THT, THR 또는 SMD 솔더링 프로세스
- 180° (수직/직립) 또는 90° (수평/평면) 디자인 유형으로 이용 가능
- 트레이(TY) 또는 테이프 온 릴(RL)에 담아 포장
- 내부식성 향상을 위한 강화 골드 레이어
- 빠른 데이터 전송을 위한 10 Gbit/s의 데이터 속도를 지원하는 USB 3.1 잭
- 대칭적인 디자인으로 오류 없이 꽂을 수 있는 USB-C 잭
- 강력한 Plug & Play 작동 - 시스템을 종료하거나 다시 시작하지 않고 연결 및 분리

**일반 주문 데이터**

버전	OMNIMATE 데이터 - USB 잭, PCB 플러그인 커넥터, USB 3.0, 유형 B, 480 Mbps, THT 용접 결선, 180°, 플러그 주기: ≥ 1500, 극 수: 4, PBT, 금 도금 니켈, 트레이 (수작업 조립)
주문 번호	<a href="#">2710810000</a>
유형	USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118757866
수량	110 items
파키징	트레이 (수작업 조립)
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-11-01T00:00:00+01:00

**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	11.2 mm	깊이 (인치)	0.4409 inch
높이	16.1 mm	높이 (인치)	0.6339 inch
너비	12.2 mm	폭 (인치)	0.4803 inch
순중량	3.76 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**전기 속성**

절연 강도, 접점/접점	500 V AC	절연 저항	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
공칭 전압	30 V		

**시스템 사양**

극 수	4	LED	아니요
슬더 핀 길이(I)	3.05 mm	PCB에 장착	THT 용접 결선
피치(인치)(P)	0.098 "	차폐 재질	황동
차폐	Yes	측면 종단, 특성	용접 플랜지
전송 속도	480 Mbps	결선 유형	용접 결선
제품군	OMNIMATE 데이터 - USB 잭	피치(mm)(P)	2.50 mm
보호 등급	IP20	플러그 주기	$\geq 1500$
외향 엘보	180°	차폐 표면	니켈 도금
실드 탭	없음	성능 카테고리	480 Mbps
슬더링 프로세스	수작업 슬더링, 웨이브 슬더링	슬더핀 크기	8각형
슬더핀 위치의 공차	$\pm 0.1 \text{ mm}$		

**자재 데이터**

절연재	PBT	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연 저항	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)		UL 94 가연성 등급	V-0
접점 기본 재질	구리 합금	접점 재질	구리 합금
접점 표면	금 도금 니켈	플러그 접점의 레이어 구조	30 $\mu\text{m}$ Au
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-40 °C	작동 온도, 최대	85 °C

**패키징**

패키징	트레이 (수작업 조립)	VPE 길이	310.00 mm
VPE 폭	230.00 mm	VPE 높이	14.00 mm

**중요 참고 사항****참고 사항**

**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****분류**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

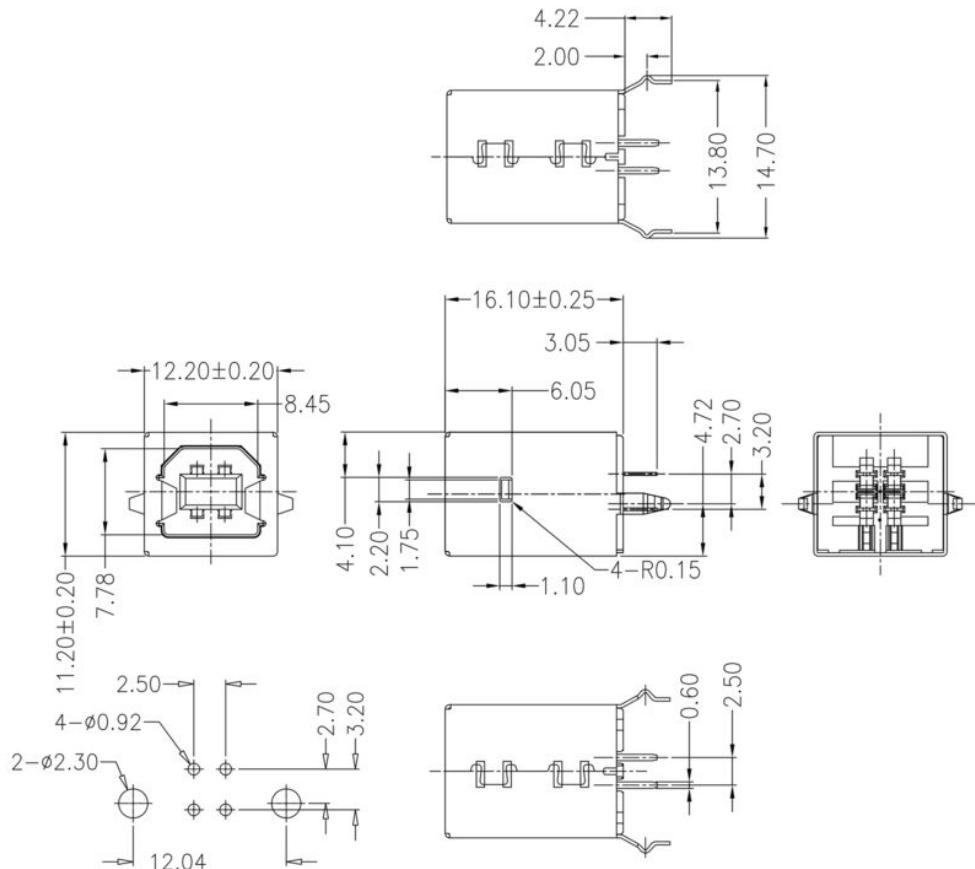
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

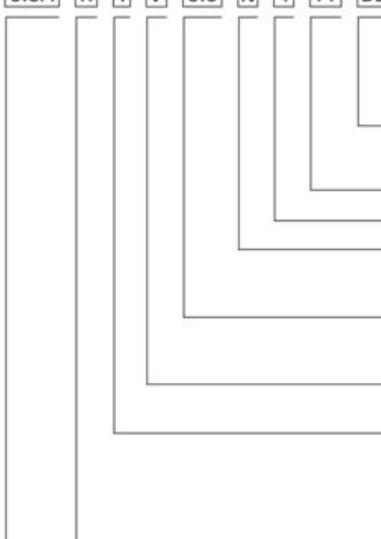
**USB2.0B T1V 3.0N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

범례

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL
										
<b>Colour / Special Option</b>	<b>BL</b>	blue (plastic)								
	<b>BK</b>	black (plastic)								
	<b>WH</b>	white (plastic)								
	<b>SO</b>	customized product								
<b>Packaging</b>	<b>TY</b>	Tray in box (manual assembly)								
	<b>RL</b>	Tape on Reel (automated assembly)								
	<b>TU</b>	Tube								
<b>Contact surface thickness</b>	<b>4</b>	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", <b>4 = 30µ"</b> , 5 = 50µ"								
	<b>N</b>	no use								
<b>Solder Pin length</b>	<b>3.2</b>	3.2 mm								
	<b>1.6</b>	1.6 mm								
	<b>D</b>	SMD								
<b>Direction</b>	<b>H</b>	Horizontal (90°, side entry)								
	<b>U</b>	Horizontal, Upright 90°								
	<b>V</b>	Vertical (180°, top entry)								
<b>Number of Ports</b>	<b>1</b>	1 Port								
	<b>21; 41; ...</b>	multi ports about each other, Multilevel								
<b>Assembly on PCB</b>	<b>R</b>	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering								
	<b>S</b>	Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering								
	<b>T</b>	Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave								
<b>Type / Performance</b>	<b>2.0A</b>	USB 2.0 Type A								
	<b>3.0A</b>	USB 3.0 Type A								